

<<实用表面组装技术>>

图书基本信息

书名：<<实用表面组装技术>>

13位ISBN编号：9787121017377

10位ISBN编号：7121017377

出版时间：2006-1

出版时间：电子工业出版社

作者：张文典

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用表面组装技术>>

内容概要

表面组装技术（SMT）发展已有40年的历史，现已广泛应用于通信、计算机、家电等行业，并正在向高密度、高性能、高可靠性和低成本方向发展。

本书较详细地介绍了SMT的相关知识。

全书共有17章，包括焊接机理、热传导基本概念、各种辅助材料的特性与评估方法、各种焊接设备的热传导特点和焊接曲线的设定、贴片机验收标准、焊点质量评价与SMA性能测试技术、SMT大生产中的防静电及质量管理等，再版后又新增加了SMB优化设计以及无铅焊料和无铅工艺，包括如何实施无铅波峰焊和无铅再流焊。

本书内容丰富、实用性强，对SMT行业相关人员的继续教育和工作实践都有很高的参考价值。

<<实用表面组装技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>